

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】平成 21 年 5 月 28 日 (2009.5.28)

【公表番号】特表 2008-546211 (P2008-546211A)

【公表日】平成 20 年 12 月 18 日 (2008.12.18)

【年通号数】公開・登録公報 2008-050

【出願番号】特願 2008-515690 (P2008-515690)

【国際特許分類】

H 0 1 L 23/02 (2006.01)

H 0 1 L 51/05 (2006.01)

H 0 1 L 51/50 (2006.01)

H 0 5 B 33/04 (2006.01)

H 0 1 L 31/02 (2006.01)

H 0 1 L 31/042 (2006.01)

H 0 1 L 23/10 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 23/02 C

H 0 1 L 29/28 1 0 0 A

H 0 5 B 33/14 A

H 0 5 B 33/04

H 0 1 L 31/02 B

H 0 1 L 31/04 R

H 0 1 L 23/10 B

【手続補正書】

【提出日】平成 21 年 4 月 2 日 (2009.4.2)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

気密封止パッケージであって、

有機電子デバイスが載置されるように構成された基板と、

基板の上面に配設された有機電子デバイスと、

有機電子デバイスの上方に配設された絶縁接着剤層と、

絶縁接着剤層に結合されかつ有機電子デバイスに近接して配設された上板であって、上板は当該パッケージの縁端をくるむように形成された周辺部を有していて、上板の周辺部は有機電子デバイスの反対側に位置する基板の下面に結合されている上板と、

上板の周辺部が基板の下面に気密封止されるようにして基板の下面に配設された合金シーラント層と、

合金シーラント層と基板の下面との間及び合金シーラント層と上板の周辺部との間に配設されたスズからなるプライマー層と、

当該パッケージの縁端を上板でくるむことで形成されたポケットの内部に配設された脱湿剤と

を含んでなる気密封止パッケージ。

【請求項 2】

前記基板が可撓性基板からなる、請求項 1 記載の気密封止パッケージ。

【請求項 3】

前記基板が複合構造体からなる、請求項 1 記載の気密封止パッケージ。

【請求項 4】

前記基板がポリマー材料からなる、請求項 1 記載の気密封止パッケージ。

【請求項 5】

前記基板がプラスチック、金属箔又はガラスからなる、請求項 1 記載の気密封止パッケージ。

【請求項 6】

前記基板と有機電子デバイスとの間に配設されたバリヤーコーティングを含む、請求項 1 記載の気密封止パッケージ。

【請求項 7】

前記有機電子デバイスが有機エレクトロルミネセントデバイス又は有機光起電力デバイスからなる、請求項 1 記載の気密封止パッケージ。

【請求項 8】

前記合金シーラント層がビスマス又はスズ又は鉛又はインジウム又はカドミウム又はこれらの組合せの合金からなる、請求項 1 記載の気密封止パッケージ。

【請求項 9】

ビスマスの体積百分率が 0 ~ 50 % の範囲内にあり、又はスズの体積百分率が 5 ~ 50 % の範囲内にあり、又は鉛の体積百分率が 0 ~ 50 % の範囲内にあり、又はインジウムの体積百分率が 0 ~ 55 % の範囲内にあり、又はカドミウムの体積百分率が 0 ~ 15 % の範囲内にある、請求項 9 記載の気密封止パッケージ。